



2025年3月期 第3四半期 決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2025年2月6日

3Q累計業績サマリー

* 3Q累計：4月～12月

■ 売上高・利益

➤ 前年比 増収増益

売上高 566億円（18%増）、営業利益 93.0億円（15%増）
半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 受注高

➤ 半導体前・後工程とも回復

受注高545億円（17%増）、2Q比（QoQ）13%増加
半導体前工程は、顧客拡大に伴い、ロジック/ファウンドリ向け枚葉式リン酸エッチング装置が増加、
半導体後工程は、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調。

■ 受注残高

➤ 2024年12月末 578億円

■ 業績予想

➤ 通期業績予想、年間配当予想は前回予想から変更なし

2024/3Q 実績 (1)

3Q累計業績結果（対前年）①

（単位：億円）

	2023						2024			3Q 累計	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	3Q 累計	4Q	年度	1Q	2Q	3Q		
売上高	143	162	174	479	197	676	171	193	202	566	+18%
営業利益	21.3	28.9	30.8	81.0	35.8	116.9	30.7	26.8	35.5	93.0	+15%
R O S	14.9%	17.8%	17.8%	16.9%	18.2%	17.3%	17.9%	13.9%	17.6%	16.4%	-0.5pt
経常利益	22.1	28.2	29.7	80.0	36.1	116.1	31.4	24.1	36.3	91.8	+15%
当期純利益	18.0	20.7	21.8	60.5	27.4	87.9	22.9	18.1	28.5	69.5	+15%
受注高	177	156	133	466	152	618	213	156	176	545	+17%

2024/3Q 実績 (2)

3Q累計業績結果（対前年）②

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比 18%増収 (479億円 ⇒ 566億円)
 - SPE分野が増加、FPD分野は微増、流通機器分野が改刷特需により増加。

- 営業利益 前年比 15%増益 (81.0億円 ⇒ 93.0億円)
 - SPE分野、流通機器分野の売上増加により増益。
ただし、持続的成長に向けた投資中心に販管費増加。

- 受注高 前年比 17%増加 (466億円 ⇒ 545億円)
 - 半導体前工程のロジック/ファウンドリ向け装置、後工程の生成AI用GPU用途を含む先端パッケージ向け装置が好調に推移。流通機器分野が改刷特需により増加。

セグメント別 3Q累計業績結果（対前年）①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

- 売上高 前年比 1%減 (356億円 ⇒ 353億円)
半導体前工程では、前年度受注減少の影響を受け減少。
FPD前工程では、低調で微増。
- セグメント利益 前年比 23%減 (72.9億円 ⇒ 56.3億円)
半導体前工程の売上減少、販管費の増加等により減益。
- 受注高 前年比 16%増 (288億円 ⇒ 334億円)
ロジック/ファウンドリ向け装置が好調に推移、Siウェーハ向け装置は3Qから回復傾向。
FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

2024/3Q 実績 (4)

セグメント別 3Q累計業績結果 (対前年) ②

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

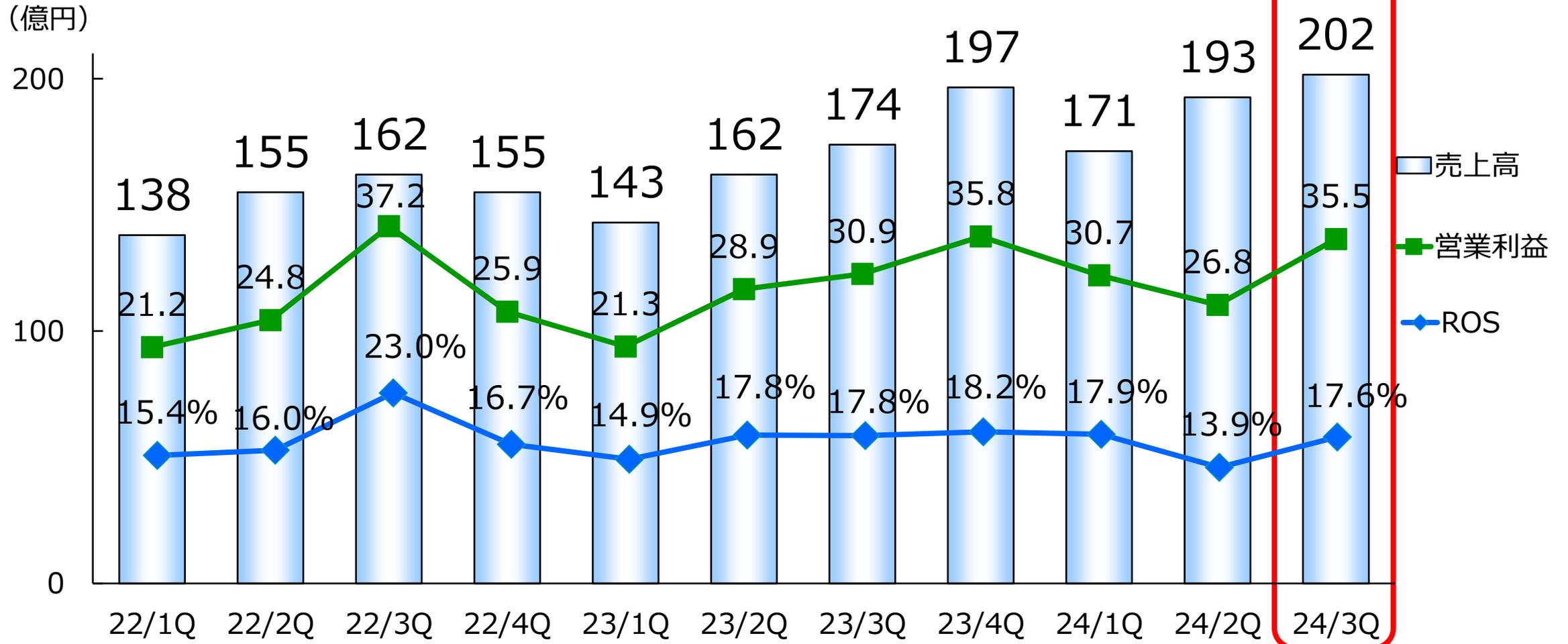
- **売上高** 前年比 72%増 (88億円 ⇒ 152億円)
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。
FPD後工程では、低調で前年同等。
真空応用装置では、半導体分野向けが堅調で増加。
- **セグメント利益** 前年比 196%増 (10.2億円 ⇒ 30.2億円)
半導体後工程及び真空応用装置の売上増加により大幅増益。
- **受注高** 前年比 20%増 (131億円 ⇒ 157億円)
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

2024/3Q 実績 (5)

売上高・利益・ROS

ROS17.6%

(億円)

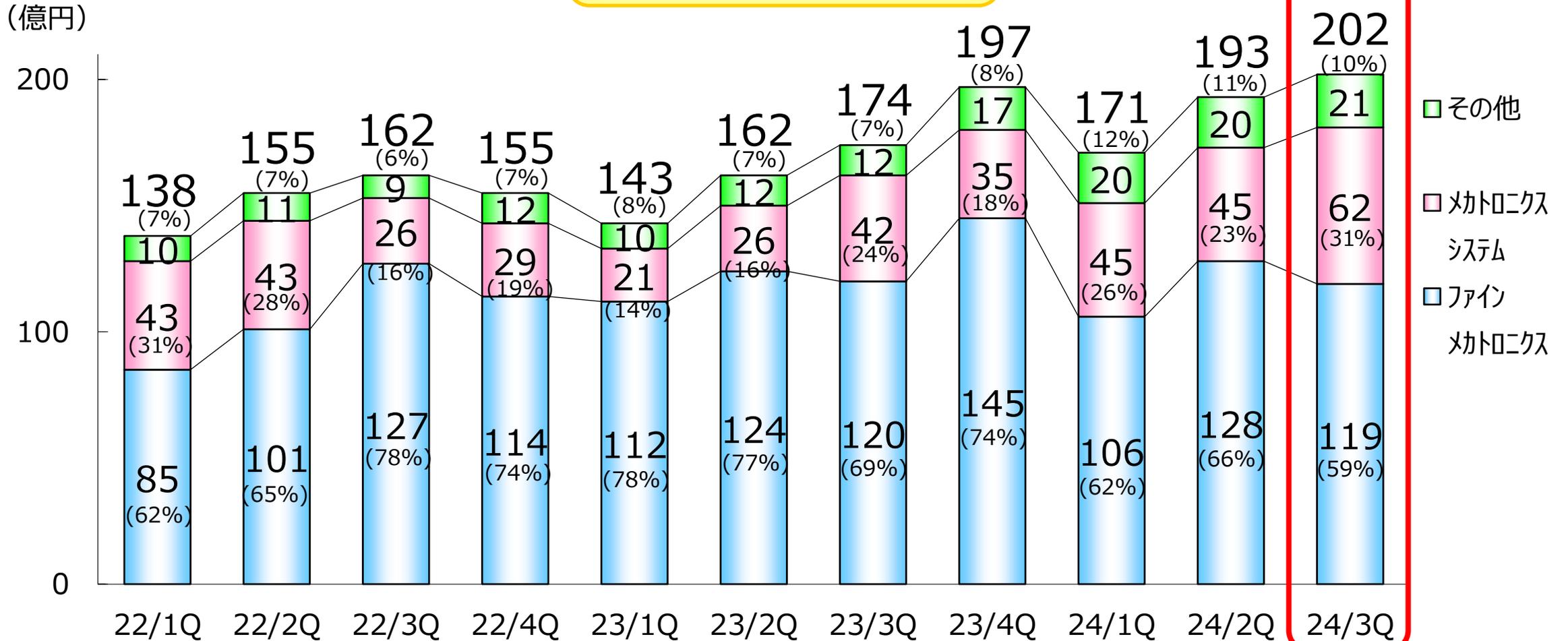


2024/3Q 実績 (6)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 59%
メカトロニクスシステム 31%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



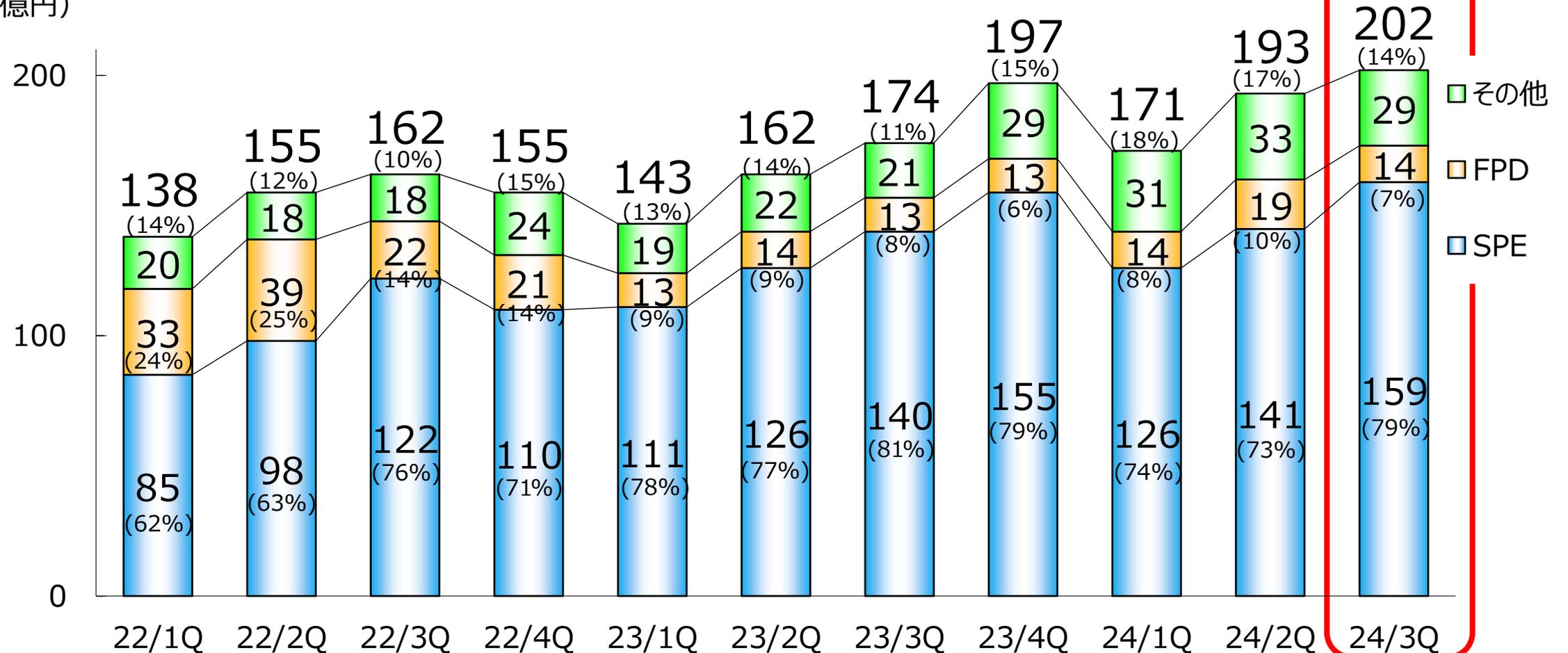
2024/3Q 実績 (7)

分野別売上高

SPE分野 79%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)

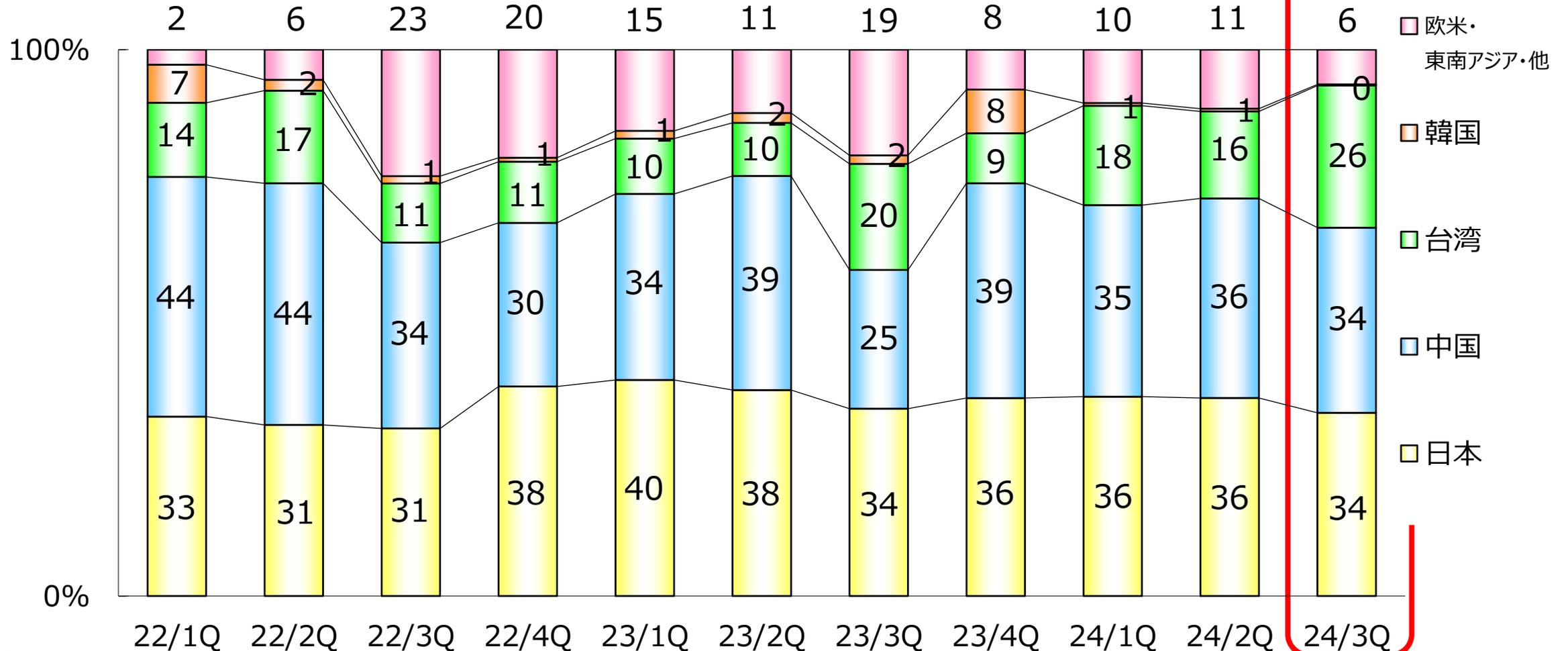


2024/3Q 実績 (8)

地域別売上高比率

海外向け66% (中国34%、台湾26%)

* 仕向地で区分



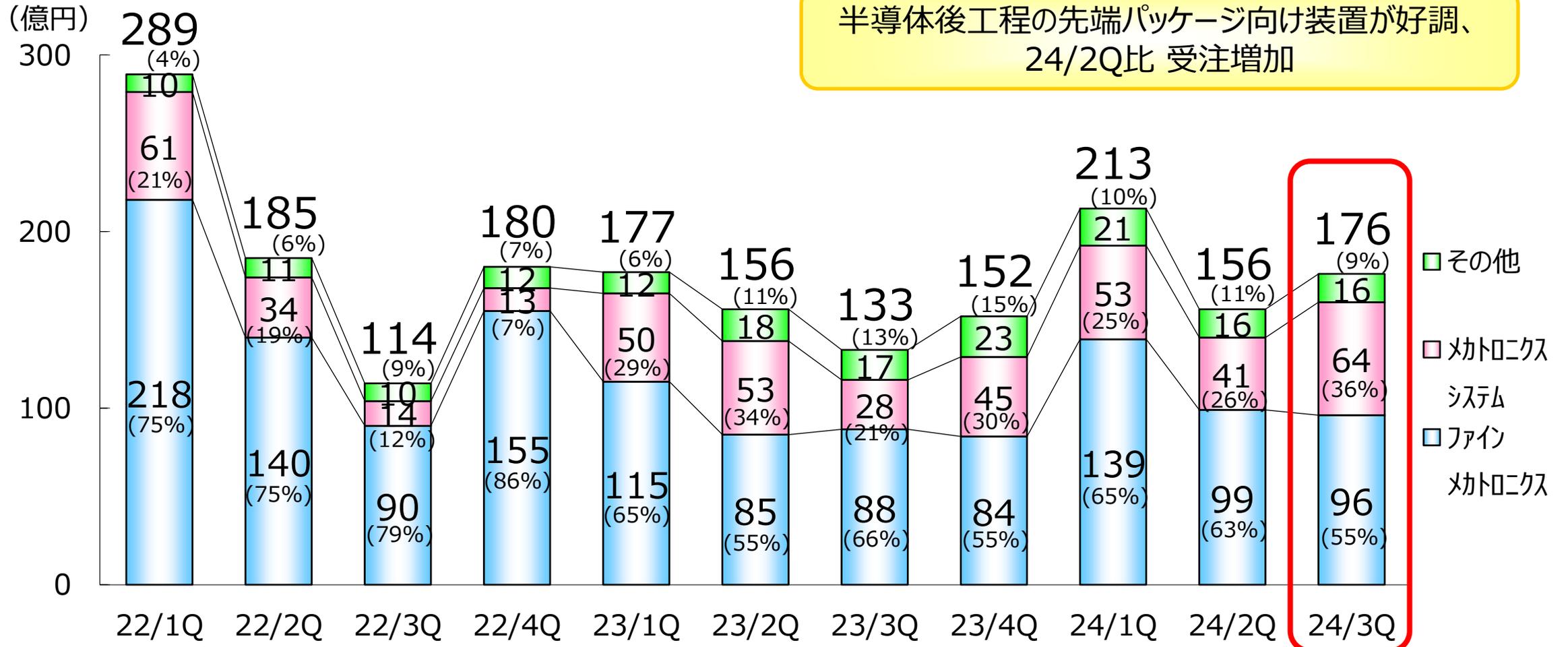
2024/3Q 実績 (9)

セグメント別受注高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置

エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

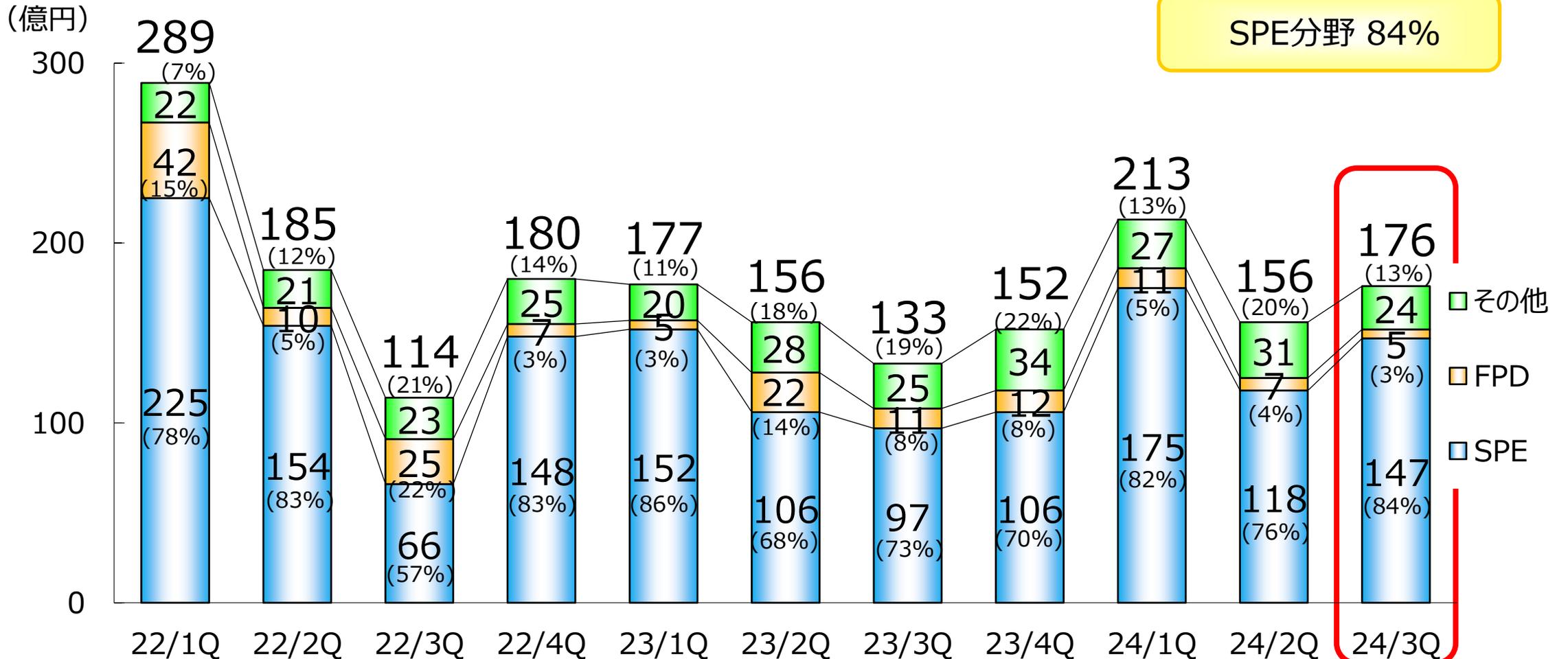
半導体後工程の先端パッケージ向け装置が好調、
24/2Q比 受注増加



2024/3Q 実績 (10)

分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

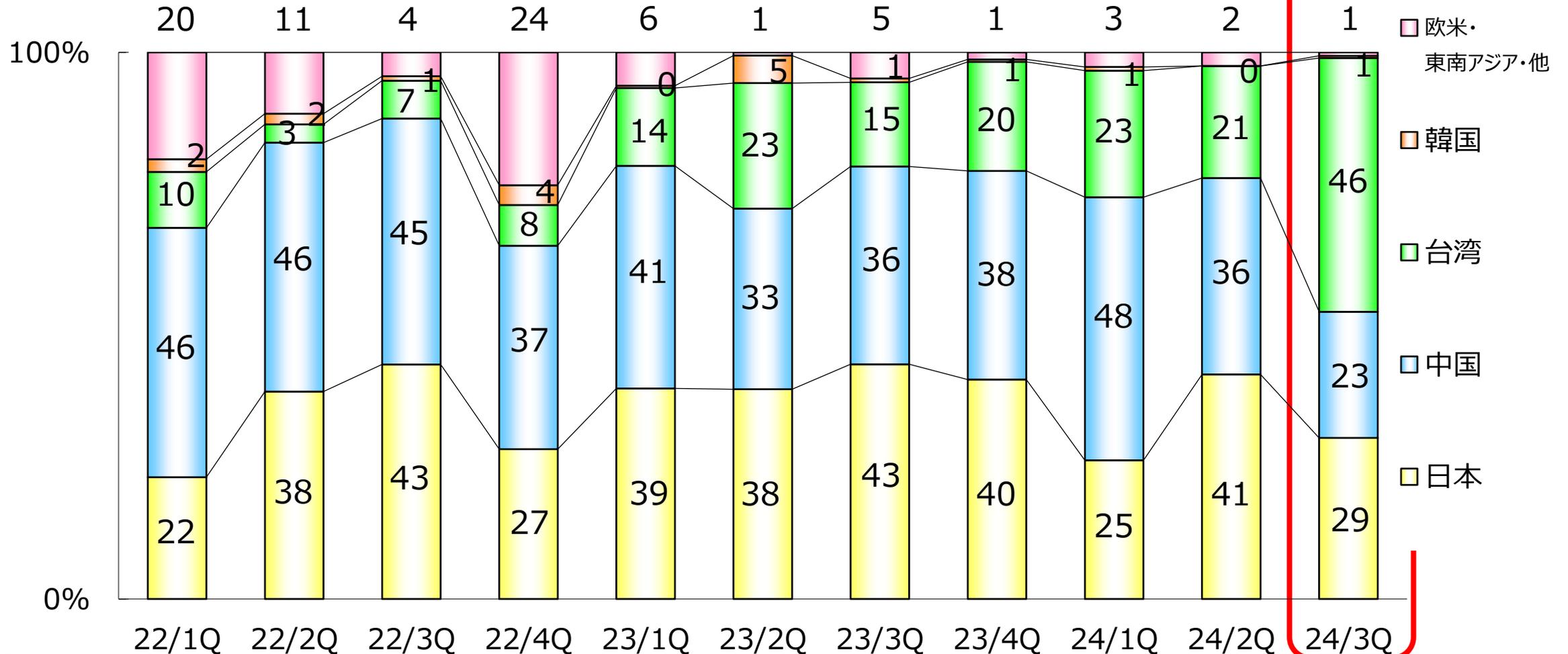


2024/3Q 実績 (11)

地域別受注高比率

海外向け71% (台湾46%、中国23%)

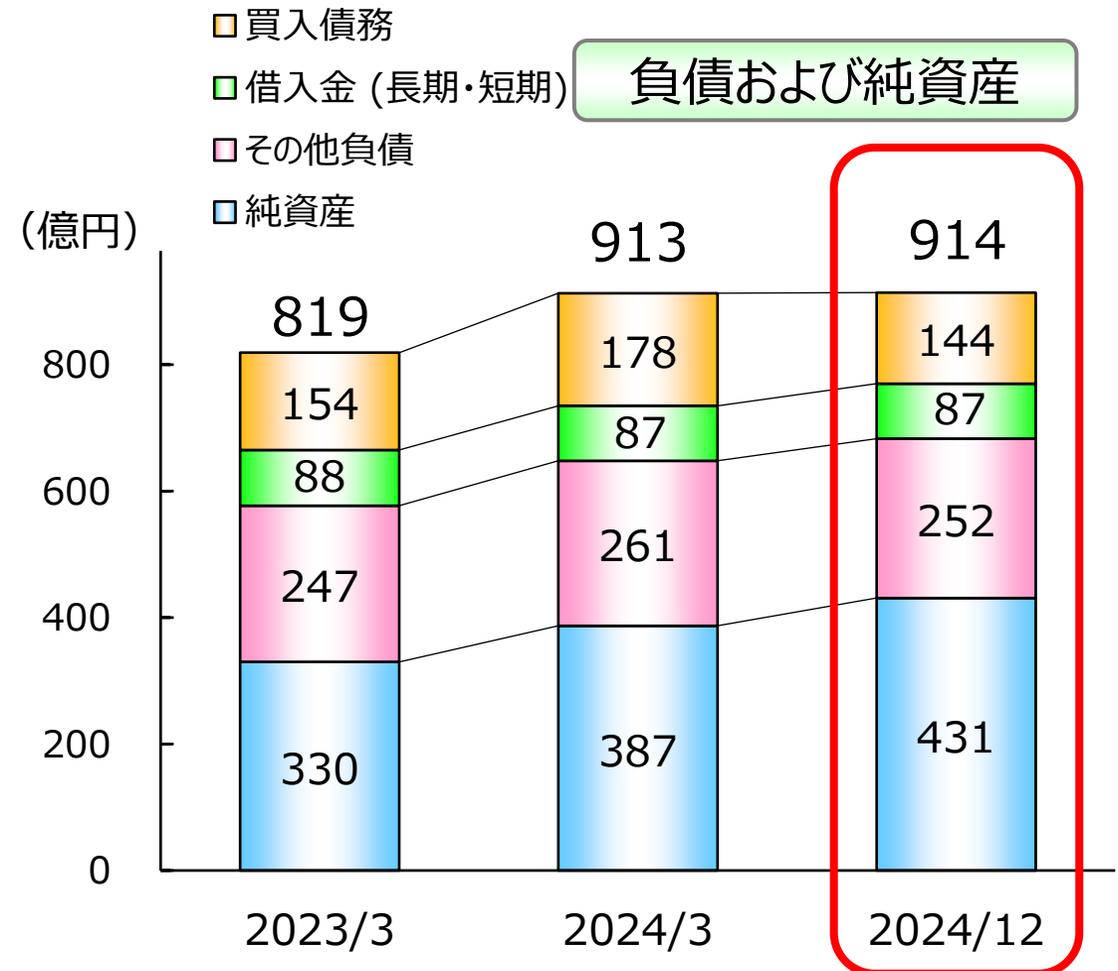
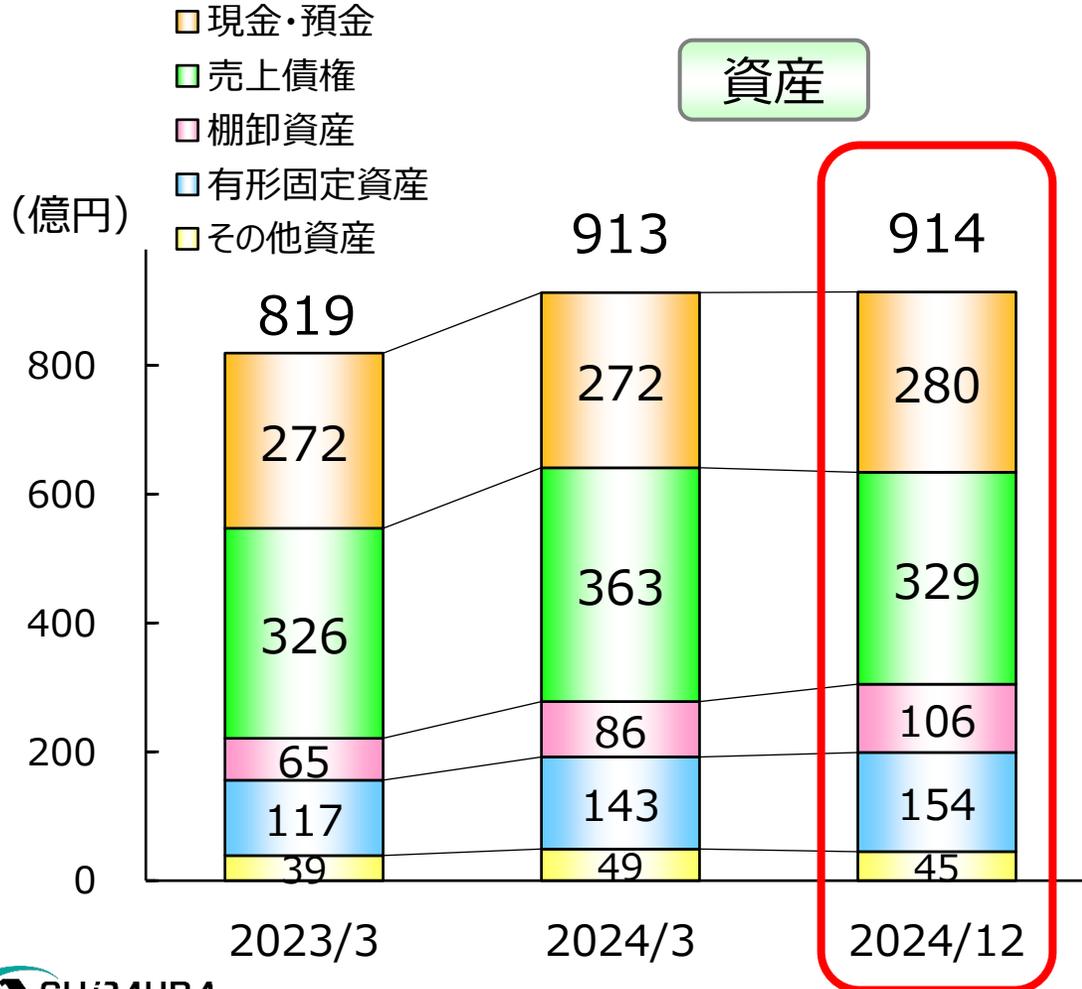
* 仕向地で区分



2024/3Q 実績 (12)

貸借対照表

自己資本比率 42% ('24/3) → 47% ('24/12)
 D/Eレシオ 0.23倍 ('24/3) → 0.20倍 ('24/12)



2024年度 業績予想 (1)

業績予想

前回予想から通期業績予想変更なし

*1: 2024年5月公表, *2: 2024年8月公表

*3: 2024年11月公表

(単位: 億円)

	2021 年度	2022 年度			2023 年度			2024 年度 予想	前回予想 *3 2024 年度	前々回予想 *2 2024 年度	期初予想 *1 2024 年度
			23/3Q 累計	23/4Q		24/3Q 累計実績	24/4Q 予想				
売上高	493	610	479	197	676	566	185	751	751	730	700
営業利益	50.5	109.1	81.0	35.9	116.9	93.0	31.0	124.0	124.0	118.0	100.0
R O S	10.3%	17.9%	16.9%	18.2%	17.3%	16.4%	16.7%	16.5%	16.5%	16.2%	14.3%
経常利益	48.8	105.1	80.0	36.1	116.1	91.8	29.2	121.0	121.0	117.0	96.0
当期純利益	29.8	92.0	60.5	27.4	87.9	69.5	21.5	91.0	91.0	88.0	72.0
R O E	12.8%	31.9%	-	-	24.5%	-	-	21.6%	21.6%	21.0%	17.6%
F C F	77.9	32.0	-	-	36.8	-	-	6.0	6.0	6.0	6.0

2024年度 業績予想 (2)

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。

期末配当は前回予想から変更なし、243円（配当性向 35.0%）を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想（2025年3月期）	0円	243円	243円
前回予想（2025年3月期）	0円	243円	243円

（ご参考）2024年3月期 年間配当200円

3Qトピックス（2Qご紹介 SPE分野新製品進捗）

前工程

FOSB／FOUP洗浄装置「FOC300」

当社の洗浄技術、真空技術、検査技術を
結集したハイエンド仕様の洗浄装置

半導体の微細化に伴い
求められる、更なる高
清浄度、品質管理を可能と
した新製品をラインナップ

- 評価用装置受注
- 引合い・新規お問い合わせ多数

- * FOSB : Front Opening Shipping Box
工場間のウェーハ搬送などに使用
- * FOUP : Front Opening Unified Pod
工場内で装置間の搬送などに使用



環境調和型
製品

後工程

ハイエンドウェーハレベル パッケージボンダ「TFC-6600」

アプリケーションプロセッサをはじめ高密度FO-WLP市場
で豊富な実績があるTFC-6100Wの後継・上位機種

アプリケーションプロセッサ
などのUHD FO-WLP
製品およびシリコンブリッ
ジ実装など、高精度な
実装に対応

- 量産用装置の受注好調

- * UHD FO-WLP : Ultra High Density
Fan Out-Wafer Level Package



環境調和型
製品

A hand is shown at the bottom, holding a glowing digital globe. The globe is composed of a grid of dots and is overlaid with a complex network of glowing blue lines and squares, resembling a circuit board or data flow. The background is a deep blue with a subtle pattern of light dots.

この先もずっと、
人と技術で
社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、

「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で

お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、

豊かな社会の実現を支えてまいります。

見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。